|  |
| --- |
| [2023年中国驱动IC用COF行业现状研究分析与发展趋势预测报告](https://www.20087.com/M_JiXieJiDian/06/QuDongICYongCOFWeiLaiFaZhanQuShi.html) |



#### [中国市场调研网](https://www.20087.com/)

[www.20087.com](https://www.20087.com/)

一、基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 名称： | [2023年中国驱动IC用COF行业现状研究分析与发展趋势预测报告](https://www.20087.com/M_JiXieJiDian/06/QuDongICYongCOFWeiLaiFaZhanQuShi.html) |
| 报告编号： | 1635606　　←电话咨询时，请说明该编号。 |
| 市场价： | 电子版：8500 元　　纸介＋电子版：8800 元 |
| 优惠价： | 电子版：7600 元　　纸介＋电子版：7900 元　　可提供增值税专用发票 |
| 咨询电话： | 400 612 8668、010-66181099、010-66182099、010-66183099 |
| Email： | Kf@20087.com |
| 在线阅读： | [<https://www.20087.com/M_JiXieJiDian/06/QuDongICYongCOFWeiLaiFaZhanQuShi.html>](https://www.20087.com/2/95/ZhiNengXiWanJiShiChangQianJingYuCe.html) |
| 温馨提示： | 订购英文、日文等版本报告，请拨打订购咨询电话或发邮件咨询。 |

二、内容简介

　　驱动IC用COF（Chip On Film）作为一种用于显示面板的高密度连接技术，近年来随着显示技术的不断进步而得到快速发展。目前，COF技术主要应用于液晶显示器（LCD）和有机发光二极管显示器（OLED）等领域，通过将驱动IC直接封装在柔性电路板上，实现轻薄化、窄边框的设计目标。COF技术的优势在于它可以减少布线空间，提高显示面板的分辨率，同时还能降低功耗。随着智能手机、平板电脑等移动设备对屏幕显示效果要求越来越高，COF技术的应用范围也在不断扩大。不过，COF技术在生产过程中也面临着良率控制、成本控制等难题，如何提高生产效率、降低成本成为行业发展的关键。
　　未来，驱动IC用COF技术将朝着更高集成度、更低功耗的方向发展。一方面，技术进步将继续推动COF技术性能的提升，例如通过优化电路设计，实现更高的集成度和更快的数据传输速度；另一方面，随着显示技术的发展，COF技术需要不断适应新的显示需求，如支持更高刷新率、更大尺寸的显示屏。此外，环保理念的普及也将促使COF技术向更加环保的方向发展，采用可回收材料、优化生产工艺，减少对环境的影响。标准化建设对于提升行业整体水平至关重要，通过建立严格的技术标准，规范市场秩序，保障产品质量。最后，随着5G等新技术的应用，COF技术将面临新的发展机遇，如支持更高分辨率、更快响应速度的显示需求，推动显示行业的创新发展。
　　《[2023年中国驱动IC用COF行业现状研究分析与发展趋势预测报告](https://www.20087.com/M_JiXieJiDian/06/QuDongICYongCOFWeiLaiFaZhanQuShi.html)》基于对驱动IC用COF行业的深入研究和市场监测数据，全面分析了驱动IC用COF行业现状、市场需求与市场规模。驱动IC用COF报告详细探讨了产业链结构，价格动态，以及驱动IC用COF各细分市场的特点。同时，还科学预测了市场前景与发展趋势，深入剖析了驱动IC用COF品牌竞争格局，市场集中度，以及重点企业的经营状况。驱动IC用COF报告旨在挖掘行业投资价值，揭示潜在风险与机遇，为投资者和决策者提供专业、科学、客观的战略建议，是了解驱动IC用COF行业不可或缺的权威参考资料。

第一章 COF产品概述
　　第一节 COF的定义
　　第二节 COF品种
　　第三节 COF——目前的主流挠性IC封装形式
　　　　一、IC封装
　　　　二、IC封装基板与常规印制电路板在性能、功能上的差异
　　　　三、IC封装基板的种类
　　第四节 COF与TAB、TCP、Tape BGA/CSP在定义上的区别
　　第五节 COF在驱动IC中的应用
　　第六节 COF行业与市场发展概述

第二章 COF的结构及其特性
　　第一节 COF 的结构特点
　　第二节 COF 在LCD驱动IC 应用中的特性
　　第三节 COF与其它IC驱动IC封装形式的应用特性对比
　　　　一、COF与COG比较
　　　　二、COF与TAB比较
　　第四节 未来COF在结构及其特性上的发展前景
　　　　一、制作线宽/线距小于30μm的精细线路封装基板
　　　　二、卷式（ Roll to Rol l） 生产方式的发展
　　　　三、多芯片组装（MCM）形式的COF
　　第五节 COF的更高阶封装形式——基于挠性基板的3D封装的发展
　　　　一、从2D发展到3D的挠性基板封装
　　　　二、基于挠性基板的3D 封装的主要形式

第三章 驱动IC产业现状与发展
　　第一节 驱动IC的功能与结构
　　　　一、驱动IC的功能及与COF的关系
　　　　二、驱动IC的结构
　　　　三、驱动IC的品种
　　第二节 驱动IC在发展LCD中具有重要的地位
　　第三节 大尺寸TFT- LCD驱动及其特点
　　　　一、大尺寸TFT- LCD驱动特点
　　　　二、大尺寸TFT- LCD驱动芯片设计难点
　　第四节 驱动IC产业的特点
　　第五节 世界显示驱动IC的市场现况
　　　　一、显示驱动IC制造厂商与下游LCD面板厂家的关系及分析
　　　　二、世界显示驱动IC设计业现况
　　　　三、世界显示驱动IC市场规模调查统计
　　第六节 世界显示驱动IC主要生产厂家的现况

第四章 液晶面板应用市场现状与发展
　　第一节 世界液晶面板市场规模与生产情况概述
　　　　一、世界液晶面板市场变化
　　　　二、世界面板市场品种的格局
　　　　三、台、中、日、韩面板产业发展及趋势分析
　　第二节 世界大尺寸TFT-LCD应用市场发展现况
　　　　一、世界大尺寸面板市场规模总述
　　　　二、液晶电视领域对大尺寸面板的需求情况
　　　　三、平板电脑领域对大尺寸面板的需求情况
　　　　四、显示器领域对大尺寸面板的需求情况
　　　　五、对2023年世界大尺寸面板市场需求的预测
　　第三节 我国液晶面板市场规模与生产情况概述
　　　　一、我国驱动IC设计行业的情况
　　　　二、我国液晶面板产业的发展
　　　　三、我国液晶面板生产现况与未来几年发展预测

第五章 COF的生产工艺及技术的发展
　　第一节 COF制造技术总述
　　　　一、COF的问世
　　　　二、COF的技术构成
　　第二节 COF挠性基板的生产工艺技术
　　　　一、COF挠性基板生产的工艺过程总述及工艺特点
　　　　二、挠性基板材料的选择
　　　　三、精细线路的制作
　　第三节 IC 芯片的安装技术
　　第四节 COF挠性基板的主要性能指标

第六章 世界COF基板的生产现状
　　第一节 全世界COF 基板生产量统计
　　第二节 全世界COF市场格局
　　第三节 全世界COF基板主要生产厂家
　　第四节 全世界COF 基板主要生产情况
　　　　一、日本COF基板厂家
　　　　二、韩国COF基板厂家
　　　　三、中国台湾COF基板厂家

第七章 世界COF基板的生产现状
　　第一节 我国FPC业的现状
　　第二节 我国COF的生产现况
　　第三节 我国COF基板的生产企业现况
　　　　一、国内COF基板生产企业发展概述
　　　　二、深圳丹邦科技有限公司
　　　　三、三德冠精密电路科技有限公司

第八章 COF挠性基板用二层型挠性覆铜板特性与生产现状
　　第一节 二层型挠性覆铜板品种及特性
　　第二节 挠性覆铜板产品主要采用的标准及性能要求
　　第三节 挠性覆铜板的生产工艺
　　　　一、三层型挠性覆铜板的生产工艺
　　　　二、二层型挠性覆铜板的生产工艺
　　第四节 世界挠性覆铜板生产现状及主要生产厂家
　　　　一、总述
　　　　二、日本FCCL业生产现状与发展
　　　　三、美国、欧洲FCCL业的现状与发展
　　　　四、中国台湾FCCL业的现状与发展
　　　　五、韩国FCCL业的现状与发展
　　第五节 中⋅智⋅林⋅－我国国内挠性覆铜板生产现状及主要生产厂家
　　　　一、我国国内挠性覆铜板业发展总述
　　　　二、我国国内挠性覆铜板生产厂家现况

图目录
　　图1-1 COF 结构示意图
　　图1-2 COF基板的产品形态
　　图1-3 COF在液晶显示器中应用及结构位置
　　图1-4 两类不同构造的COF
　　图1-5 COF在TFT-LCD中作为驱动IC的一种封装形式的应用
　　图2-1 COF在LCD面板上安装形式
　　图2-2 COF、ACF、PCB、LCD面板之间的接合形式实例
　　图2-3 COF的结构与安装形式 1、
　　图2-4 COF挠性基板的结构与安装形式 2、
　　图2-5 LCD的驱动IC的三种安装构造形式
　　图2-6 COG和COF的驱动IC在液晶显示器上应用的分辨率比较
　　图2-7 TAB上的IC芯片结合方法及其连接部外观
　　图2-8 TAB 悬空引线变形情况例
　　图2-9 COF带上IC芯片接合方法和接合部外观及基材构造
　　图2-10 安装有无源器件的COF实例
　　图2-11 2018-2023年间COF上的引线间距尺寸发展趋势
　　图3-1 驱动IC结构图
　　图3-2 液晶产业的产业链及供货结构
　　图3-3 2018-2023年中国台湾与韩国主要面板驱动IC设计业者营收成长率变化
　　图3-4 2018-2023年全球显示驱动IC市场规模统计
　　图3-5 世界液晶显示驱动IC的市场格局情况
　　图4-1 全球液晶显示面板市场2022-2023年的变化发展
　　图4-2 2023-2029年全球主要应用面板市场的统计、预测
　　图4-3 2023-2029年平板显示按技术类别出货面积的统计、预测
　　图4-4 当前世界面板市场品种的格局
　　图4-5 OLED市场销售额统计
　　图4-6 OLED市场销售额统计
　　图4-7 显示器产品的大尺寸TFT-LCD面板使用驱动IC（COF）的情况
　　图4-8 2022-2023年世界大尺寸面板各应用领域需求量的变化
　　图4-9 2023年大尺寸面板供给与需求情况
　　图4-10 OLED电视和4K液晶电视的出货预测
　　图4-11 2023年与2023年电视面板厂按尺寸段出货预测
　　图4-12 2023-2029年平板电脑按分辨率统计、预测的出货比率
　　图4-13 2023-2029年汽车显示器出货量统计、预测
　　图4-14 2023年全球大尺寸面板供需比较
　　图4-15 2022-2023年我国面板销售收入与中国台湾、韩国、日本对比
　　图4-16 2018-2023年我国液晶面板产业的规模
　　图4-17 中国大陆品牌厂商液晶面板采购来源（2015年1季度）
　　图4-18 2023年中国大陆电视面板供应的市场结构预测
　　图4-19 我国已投产及在建的4.5代至8.5代液晶面板生产线分布情况
　　图5-1 COF的整个制造工艺及与LCD面板安装的过程
　　图5-2 COF挠性基板的生产工艺过程
　　图5-3 各向异性导电膜的使用原理
　　图6-1 2018-2023年世界COF基板产销量的统计、预测
　　图6-2 2018-2023年世界COF基板销售额的统计、预测
　　图6-3 2018-2023年各国家/地区的产销COF基板市场份额变化图
　　图6-4 2018-2023年各国家/地区的COF基板市场需求份额
　　图6-5 2023年世界COF基板主要生产企业的市场比例推估
　　图7-1 2023年中国内地FPC销售额所占比例以及与日本、中国台湾、韩国对比
　　图7-2 2018-2023年我国内地COF基板产销量的统计及预测
　　图7-3 2023年丹邦科技公司生产经济运行情况
　　图8-1 两大类挠性覆铜板的结构
　　图8-2 三层型单面FCCL产品的工艺流程
　　图8-3 卷状法生产的3L-FCCL的主要工序——涂布加工过程、设备示意图
　　图8-4 采用卷状涂布工艺法制3L-FCCL的生产实况
　　图8-5 溅射法/ 电镀法生产FCCL的溅射工序所用的专用设备的构造图
　　图8-6 溅射法/ 电镀法的工艺流程
　　图8-7 三类二层型FCCL的工艺加工特点及剖面结构图
　　图8-8 2023年世界各国家、地区FCCL生产格局
　　图8-9 世界各FCCL生产厂家市场占有率
　　图8-10 日本FCCL在2018-2023年期间生产情况统计
　　图8-11 近年中国台湾FCCL产值情况
　　图8-12 2018-2023年中国台湾FCCL各类产品的产能统计
　　图8-13 2018-2023年中国台湾FCCL产品销售额统计与预测
　　图8-14 2018-2023年中国内地FCCL生产能力、实际生产量的统计及预测

表目录
图表目录
　　表1-1 半导体封装的功能
　　表2-1 COF及与COF相近的其它三种封装形式的性能特点的对比
　　表2-2 目前已出现的几种基于挠性基板的IC 封装形式实例
　　表3-1 驱动IC各部分对电压和工艺的需求
　　表3-2 LCD中下游市场划分
　　表3-3 面板分辨力与驱动IC 需求数量对照表
　　表3-4 LCD驱动IC生产厂家、芯片代工、LCD面板三者关系
　　表3-5 2018-2023年全球主要显示驱动IC厂家销售额的排名
　　表4-1 2018-2023年各类显示的市场格局变化
　　表4-2 日本、韩国和中国台湾及中国大陆产业优劣分析
　　表4-3 2018-2023年台、中、日、韩面板产业各项重要经济指标及预测
　　表4-4 世界各电视品牌商采用新液晶电视面板尺寸的情况
　　表4-5 我国大中小尺寸液晶面板生产线的投产、建设的情况
　　表5-1 一般COF挠性基板的主要性能要求指标
　　表5-2 在COF基板上安装IC芯片后的可靠性评价
　　表5-3 有关FPC产品方面的世界权威标准及标准号
　　表5-4 FPC可靠性测试项目及试验条件
　　表5-5 各个FPC品种的可靠性测试项目及试验条件
　　表6-1 2018-2023年世界COF基板销售对其未来市场的预测
　　表6-2 2018-2023年世界各国家/地区的产销COF基板产品市场份额
　　表6-2 2023年世界COF基板主要生产厂家的产能统计
　　表6-3 2023年世界COF基板主要生产厂家实际销售额及在世界上的市场份额
　　表7-1 我国国内大型或较大型FPC生产厂家情况统计
　　表8-1 两类挠性覆铜板的特性及应用比较
　　表8-2 国内外与挠性印制电路板用基板材料相关标准的题目
　　表8-3 二层型聚酰亚胺基膜FCCL（涂布法）的主要性能
　　表8-4 世界上占市场比例很大的各类FCCL主要生产厂商
　　表8-5 世界主要生产FCCL的厂家统计
　　表8-6 日本国内FCCL及其配套材料的产量的统计及预测
　　表8-7 日本在海外生产FCCL及其配套材料的产量的统计及预测
　　表8-8 日本的二层型FCCL生产厂家的情况
　　表8-9 韩国主要FCCL生产厂家情况
　　表8-10 2018-2023年国内主要生产厂家生产FCCL能力的统计
略……

了解《[2023年中国驱动IC用COF行业现状研究分析与发展趋势预测报告](https://www.20087.com/M_JiXieJiDian/06/QuDongICYongCOFWeiLaiFaZhanQuShi.html)》，报告编号：1635606，

请致电：400-612-8668、010-66181099、66182099、66183099，

Email邮箱：Kf@20087.com

详细介绍：<https://www.20087.com/M_JiXieJiDian/06/QuDongICYongCOFWeiLaiFaZhanQuShi.html>

了解更多，请访问上述链接，以下无内容！